

海通证券股份有限公司  
关于合肥新汇成微电子股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市  
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（上海市广东路 689 号）

二〇二二年三月

## 声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## 目 录

一、发行人基本情况.....	2
二、发行人本次发行情况.....	12
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....	13
五、保荐机构承诺事项.....	14
六、本次证券发行上市履行的决策程序.....	15
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明.....	15
八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明.....	17
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排.....	21
十、保荐机构和保荐代表人联系方式.....	23
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项.....	23
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.....	23

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人的基本信息

公司名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
英文名称	Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
注册资本	66,788.2625 万元
法定代表人	郑瑞俊
有限公司成立日期	2015 年 12 月 18 日
股份公司成立日期	2021 年 3 月 30 日
住所	合肥市新站区合肥综合保税区内
邮政编码	230012
电话	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099
公司网址	www.unionsemicon.com.cn
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负责人	施周峰
负责信息披露和投资者关系的部门联系电话	0551-67139968-7099

### （二）发行人的主营业务、核心技术及研发水平

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。2020 年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内排名第一，具有较强的市场竞争力。

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。

公司经过多年持续的研发投入及技术沉淀，形成了微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术等多项核心技术，目前已授权专利达 278 项，在行业内具有技术领先优势。公司围绕集成电路封装测试的行业特性，在生产工艺及生产装置等环节持续研发改进，追求高精度、高良率、高可靠性的封装测试核心能力，为显示驱动芯片的大批量国产化应用奠定了坚实的技术基础。

公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路产业的全球竞争力为使命。未来，公司将积极扩充 12 吋大尺寸晶圆的先进封装测试服务能力，保持行业及产品的领先地位，同时将进行持续的研发投入，不断拓宽封测服务的产品应用领域，积极拓展以 CMOS 影像传感器、车载电子等为代表的新兴产品领域。

### （三）发行人的主要经营和财务数据及指标

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2022〕278 号），报告期内发行人主要财务数据及财务指标如下：

项目	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
资产总额（万元）	203,792.02	174,990.63	155,189.88
归属于母公司所有者权益（万元）	139,360.11	114,247.09	19,891.90
资产负债率（母公司）（%）	26.17	27.71	71.41
营业收入（万元）	79,569.99	61,892.67	39,420.66
净利润（万元）	14,031.82	-400.50	-16,402.95
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,031.82	-400.50	-16,402.95
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,393.19	-4,190.82	-14,953.45

项目	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
基本每股收益（元）	0.21	/	/
稀释每股收益（元）	0.21	/	/
加权平均净资产收益率（%）	10.71	-0.96	-94.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	29,539.89	15,109.00	-2,238.90
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	7.62	7.62	11.52

#### （四）发行人存在的主要风险

##### 1、技术风险

###### （1）技术升级迭代的风险

随着显示面板性能需求的不断提升，OLED 等新型显示面板技术以及触控与显示驱动芯片集成技术的出现，显示驱动芯片技术朝着高分辨率、高帧率、高带宽、外围器件较少与功能高度集成化的方向发展。为了满足上述行业发展趋势，显示驱动芯片封测企业需通过设计及工艺的创新不断提升产品性能，为新产品的开发带来了更多的挑战，亦促进了 Bumping、COG 与 COF 等封装技术的发展。

目前发行人专注于显示驱动芯片先进封测领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

###### （2）公司综合技术实力与全球行业龙头相比存在差距的风险

在整个集成电路封测行业，主要公司日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技产品线均横跨封测行业多个细分领域。在显示驱动芯片封测领域，头部企业硕邦科技、南茂科技依托原有技术布局其他细分领域多年，积极开拓新的产品线。公司在封测行业其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

在未来，如果公司未能实现其他细分领域封装工艺的研发，弥补与行业头部公司在研发能力与技术实力方面的差距，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

### **(3) 其他常见的技术风险**

公司所处集成电路封测行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人员流失或不足、技术泄密等高科技企业共同面临的技术风险。

显示驱动芯片封测行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。目前中国大陆显示驱动芯片封测行业人才缺口较大，行业内人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。若公司核心技术人员流失或无法继续培养或招揽，将对公司的研发生产造成较大不利影响。

核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，若公司相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通等行为而导致公司核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生负面影响。

## **2、经营风险**

### **(1) 收入来源结构单一的风险**

自成立以来，发行人一直专注于显示驱动芯片领域，由于公司目前阶段投资能力有限，尚未正式开展其他领域业务。报告期内，发行人主营业务收入分别为 37,001.73 万元、57,504.79 万元和 76,593.90 万元，均来源于显示驱动芯片的封装测试服务，占营业收入比例分别为 93.86%、92.91%和 96.26%，收入来源结构较为单一。

如果发行人在显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，未能及时完成显示驱动芯片封测领域新的封测技术，以及 CMOS 图像传感器等其他芯片封装工艺的研发及产业化，将可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

### **(2) 市场竞争加剧及公司综合竞争力相对行业头部企业较小的风险**

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，显示驱动芯片封测领域资本不断涌入。一方面，境内行业龙头企业不断拓展产品线，如通富微电 2017 年立项研究 12 吋晶圆金凸块制造技术，进军显示驱动芯片封测领域。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，如同兴达 2021 年宣布与日月光半导体(昆山)有限公司以项目合作模式共同打造“芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目”。

报告期内，公司主营业务收入分别为 37,001.73 万元、57,504.79 万元及 76,593.90 万元，相比显示驱动芯片封测行业头部企业硕邦科技、南茂科技等，公司业务规模仍存在较大差距。硕邦科技、南茂科技发展历史较为悠久，总资产、净资产、营业收入、净利润等经营指标均高于公司，研发费用和研发涉及领域等研发指标均大于公司。

公司起步较晚，受资金、规模等方面的限制，综合竞争力亟待提升。在业务快速扩张的过程中，如果公司不能很好地应对同行业龙头企业竞争中的规模优势，将可能导致公司业务发展受阻；此外，境内外龙头企业的双重竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击。

### **(3) 客户集中度较高的风险**

报告期内，发行人对前五大客户的主营业务收入合计分别为 30,483.40 万元、43,824.32 万元和 56,284.51 万元，占主营业务收入的比例分别为 82.38%、76.21% 和 73.48%，客户集中度较高。如果未来发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，或发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

### **(4) 供应商集中度较高的风险**

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 17,621.61 万元、21,303.97 万元和 28,053.53 万元，占原材料采购总额的比例分别为 79.92%、83.14% 和 83.79%，原材料供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

### **(5) 区域贸易政策变化导致的风险**

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内 80% 以上生产设备与 40% 以上原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在 70% 以上。



如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

#### **(6) 固定资产投资大，相关折旧对盈利能力影响较大的风险**

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，都需要技术人员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点，集成电路封装测试的生产线安装后由于设备调试、生产组织、操作人员的熟练度等因素通常需要经历一段达产期。

报告期内，公司持续加大投资力度，固定资产规模持续增加，对应所产生的折旧费用保持在较高水平，各期折旧费用金额分别为 9,834.00 万元、13,859.70 万元和 16,897.19 万元。因此，在达产期前期，大额的长期资产折旧与摊销等固定成本将在一定程度上影响公司的盈利能力。

#### **(7) 公司未来发展受限于资金投入规模的风险**

鉴于集成电路封装测试重资产的行业属性，发行人未来扩建场地、购置设备扩充产能，开拓 CMOS 图像传感器、指纹传感器、射频识别等芯片封测领域，实现铜柱凸块、锡凸块等凸块制造工艺，均需大规模投入资金。如果发行人未来资金筹措能力受限，有可能影响未来的业绩增长空间。

#### **(8) 其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期的风险**

发行人计划未来投入大量资金持续建设研发中心、吸纳技术人才，研发凸块制造技术及 CMOS 图像传感器等其他细分领域封装技术。如果发行人未来在其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期，有可能影响未来的业绩增长空间。

#### **(9) 产业政策变化的风险**

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》

等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

### **3、内控风险**

#### **(1) 实际控制人借款金额较大，存在影响公司实际控制人稳定性的风险**

本次公开发行前，实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 38.78% 的表决权，本次公开发行后控制比例将进一步下降。公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展、为员工持股平台支付增资款以吸引优秀人才和维持团队稳定，以及受让股东持有的部分股权，资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至本上市保荐书签署日，公司实际控制人郑瑞俊存在多项未到期的大额负债，借款本金超过 3 亿元，负债到期时间为 2025 年 1 月至 2026 年 9 月不等。

自发行人完成首次公开发行股票并上市之日起三年后或大额负债到期后，如实际控制人不能按期偿还借款，则届时实际控制人持有的公司股份可能被债权人要求冻结、处置，存在对公司实际控制人稳定性造成不利影响的风险。

#### **(2) 公司规模扩张带来的管理风险**

报告期初，由于合肥生产基地实际订单数量与前期预测存在一定偏差，导致公司人员储备有所冗余、人力成本过高，造成公司盈利能力降低。本次发行上市后，公司规模将进一步增长，这将对管理层的管理能力带来更大的挑战。

未来，如果公司的管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

#### **(3) 财务内控不规范的风险**

在公司发展过程中，公司因资金链紧张、融资渠道少等客观原因，发生了如转贷、资金拆借等财务内控不规范的行为。针对上述内控问题，公司已积极进行整改，但若未来财务内控制度不能得到有效执行或内控不规范的情形再度发生，可能存在导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。

#### 4、财务风险

##### (1) 报告期内，公司毛利率波动较大，且未来毛利率增长不可持续的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 4.91%、19.41%和 29.62%，毛利率波动较大，呈快速上涨的趋势，主要原因系：1、随着国家产业政策的扶持鼓励、显示面板产业链向大陆转移加速以及终端应用领域的需求提升，显示驱动芯片封测服务需求持续增长；2、随着合肥 12 吋封测基地产能利用率快速攀升、产量持续提高产生规模效应，公司产品单位固定成本下降；3、随着生产经营管理水平提升及经验曲线效应显现，公司适时筹划人员优化，有效降低单位人力成本；4、公司高度重视研发投入，不断提高封测服务质量与生产良率、降低生产成本，吸引客户导入高端产品，以提供高附加值服务。

如果未来国家产业政策调整、显示驱动芯片封测需求下滑，伴随着显示驱动芯片封测市场竞争日趋激烈，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展，造成人力成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者公司研发未来受限于资金规模，不能持续有效地实施业务发展规划，保持技术与服务的领先性，提供高附加值服务，均可能导致公司毛利率无法保持较高水平。因此，公司未来毛利率增长存在不可持续的风险。

##### (2) 存在累计未弥补亏损的风险

截至 2021 年末，公司经审计的累计未弥补亏损为-22,400.72 万元，累计未弥补亏损的情形尚未消除，主要系所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。在首次公开发行股票并在科创板上市后，若公司短期内无法弥补累计亏损，将导致缺乏向股东现金分红的能力。

##### (3) 存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,176.49 万元、12,439.05 万元和 17,063.90 万元，占各期末流动资产的比例分别为 43.02%、30.90%和 36.66%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，

可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

#### **(4) 业绩波动的风险**

报告期内，公司营业收入分别为 39,420.66 万元、61,892.67 万元和 79,569.99 万元，净利润分别为-16,402.95 万元、-400.50 万元和 14,031.82 万元，业绩波动较大。2019 年和 2020 年净利润均为负，主要系公司处于持续的客户验证及产品导入阶段，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，长期资产折旧与摊销金额等成本较高所致。如果未来宏观经济景气度下行、国家产业政策出现变化、行业竞争加剧等原因导致市场对公司主要产品供需关系发生变化，可能对公司业务产生影响，公司存在业绩波动的风险。

#### **(5) 政府补助政策变化的风险**

集成电路行业系国家重点战略产业，各级政府或主管部门给予的补助政策较多，报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为 665.29 万元、4,370.80 万元和 4,296.13 万元。如果未来相关政策发生变化，公司政府补助规模无法延续，将对公司经营业绩造成一定影响。

#### **(6) 汇率波动风险**

公司的记账本位币为人民币，主要交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，受汇率波动的影响，公司汇兑损益分别为 404.48 万元、520.87 万元和 70.20 万元。如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司将面临汇兑损失的风险。

### **5、募集资金投资项目风险**

#### **(1) 募集资金投资项目的市场风险**

本次募集资金拟主要投资于公司的扩产项目建设。本次募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果募集资金投资项目未能按照计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

## **(2) 募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险**

本次募集资金投资项目规模较大，募投项目实施后固定资产规模将大幅增加。公司主要募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”建设投资为93,004.85万元，根据公司折旧政策，项目达产后将每年新增折旧摊销费用8,189.05万元，而项目产生收益需要一定的时间，因此在短期内募投项目新增折旧和摊销将对发行人经营业绩产生一定的影响。

## **6、其他风险**

### **(1) “新冠疫情”引致的风险**

2020年初，国内突发新冠疫情，给全国乃至全球经济带来了巨大冲击。目前国内的新冠疫情状况已经得到有效控制，但仍然存在零星散发、局部爆发和境外输入的情形，尤其是2021年7月-8月扬州爆发的疫情已对子公司江苏汇成的经营造成一定程度上的不利影响；同时，国外新冠疫情形势仍然严峻。若我国当前的新冠疫情防控成效不能保持或国外疫情形势加剧，可能会对宏观经济的正常运行以及公司的业务开展产生不利影响。

### **(2) 宏观经济和行业周期波动的风险**

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性。宏观经济环境以及终端市场的整体波动可能通过“牛鞭效应”对公司的经营业绩产生一定的影响。

### **(3) 首次公开发行股票摊薄即期回报的风险**

本次公开发行股票后，公司的总股本及净资产都将大幅增加。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能产生效益，公司短期内存在因股本总额及净资产增加导致每股收益、净资产收益率等即期回报指标被摊薄的风险。

### **(4) 发行失败的风险**

股票公开发行是充分市场化的经济行为，如果出现预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准，或首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网

下初始发行量等情况，按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律法规的规定，应当中止发行，公司存在发行失败的风险。

## 二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 222,627,542 股 （行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%，不超过 25%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	不超过 222,627,542 股 （行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%，不超过 25%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 890,510,167 股（行使超额配售选择权之前）		
战略配售情况	本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象包括但不限于保荐机构相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划等，具体安排参照上海证券交易所相关规定执行。相应战略配售的对象后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件并依法披露		
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象		
承销方式	余额包销		
发行费用的分摊原则	本次发行的保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担		

## 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

### （一）项目保荐代表人

本保荐机构指定何立、吴俊担任合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

何立：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部高级副总裁，持有法律职业资格证书，2017年起从事投资银行业务，曾负责或参与骏成科技IPO、之江生物IPO、肇民科技IPO、安图生物可转债、蓝天燃气IPO、天海电子IPO、湖南华菱钢铁集团可交换债券等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吴俊：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部董事总经理、注册会计师，2011年起从事投资银行业务，主要负责或参与了鹏辉能源IPO、立昂技术IPO、上海雅仕IPO、嘉泽新能IPO、金力永磁IPO、金博股份IPO、凯因科技IPO、肇民科技IPO、骏成科技IPO，以及金风科技（A+H）配股、鹏辉能源可转债、泰瑞机器非公开发行股票、立昂技术重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

## （二）项目协办人

项目原协办人已离职，本项目无协办人。

## （三）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：张鹏、奚颢、叶晟、邢丞栋、张岩、李倩、邓欣、张旭鸿

## 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

1、辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海通新动能”）共持有发行人1.91%股权。海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）系本保荐机构全资子公司，海通开元持有海通新能源私募股权投资管理有限公司（以下简称“海通新能源”）51.00%股权，海通新能源系海通新动能执行事务合伙人并持股0.67%；海通开元另持有海通新动能19.33%股权。因此，本保荐机构全资子公司海通开元通过海通新动能间接持有发行人0.37%的股份，通过海通新能源间接持有发行人0.01%的股份，本保荐机构合计持有发行人0.38%的股份。此外，本保荐机构将按照交易所相关规定，安排相关子公司参与发行人本次发行战略配售。除此之外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

## 五、保荐机构承诺事项

### 本保荐机构承诺：

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构同意推荐发行人本次证券发行上市，具备相应的保荐工作底稿支持，并据此出具本上市保荐书。

二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监



管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

## 六、本次证券发行上市履行的决策程序

本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及上交所规定的决策程序。具体情况如下：

### 1、董事会审议过程

2021年6月10日，发行人召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于<合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年分红回报规划>的议案》《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意将相关议案提交发行人2020年年度股东大会审议。

### 2、股东大会审议过程

2021年6月30日，发行人召开2020年年度股东大会。该次股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于<合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年分红回报规划>的议案》《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

## 七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明

### （一）发行人符合行业领域要求

公司所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	（1）公司是集成电路高端先进封装测试服务商，封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片。公司
--------	---	--

领域	<input type="checkbox"/> 高端装备	<p>主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。其中前段金凸块制造工序是后段倒装封装（FlipChip）工艺（即 COG 和 COF）得以实现的关键技术。</p> <p>（2）根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。</p> <p>（3）根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），公司主要封装技术属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”中的“集成电路芯片封装，采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、FlipChip、TSV 等技术的集成电路封装。”，同时公司所封测的显示驱动芯片亦属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）之“1.3.2 新型显示器件”之“新型显示材料”之“驱动 IC”。</p> <p>（4）根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。</p> <p>（5）除上述国家级分类外，公司所掌握的凸块制造技术亦为各省政府发展集成电路产业的重点支持方向之一。2018 年 2 月，安徽省政府办公厅发布《安徽省半导体产业发展规划（2018-2021 年）》，表示“提升封装测试业层次。依托长电科技、通富微电、新汇成等企业，大力发展凸块（Bumping）、倒装（Flip Chip）、晶圆级封装（WL-CSP）、硅通孔（TSV）等先进封装技术”。2020 年 2 月，广东省人民政府办公厅发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知》，提出“大力发展晶圆级封装、系统级封装、凸块、倒装、硅通孔、面板级扇外型封装、三维封装、真空封装等先进封装技术”。</p> <p>（6）根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021 年修订），公司属于第四条第（一）款规定的新一代信息技术领域。</p>
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

## （二）发行人符合科创属性要求

公司同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021 年修订）第五条科创属性规定的 4 项指标，符合科创板定位，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6,000 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司研发投入分别为 4,542.64 万元、4,715.21 万元和 6,060.30 万元，最近三年累计研发投入金额为 15,318.15 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 8.47%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例>10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2021 年 12 月 31 日，研发人员占当年员工总数比例为 15.85%，超过 10%
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	形成主营业务收入的产品涉及 18 项发明专利，超过 5 项

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司营业收入分别为 39,420.66 万元、61,892.67 万元和 79,569.99 万元，复合增长率为 42.07%，超过 20%；2021 年实现营业收入 79,569.99 万元，超过 3 亿元

## 八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明

本保荐机构对发行人符合《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

### （一）符合中国证监会规定的发行条件

#### 1、发行人组织机构健全，持续经营满3年

保荐机构调阅了发行人的工商档案、营业执照等有关资料，2015年12月，公司前身合肥新汇成微电子有限公司（简称“汇成有限”）完成工商注册。2021年3月，汇成有限召开股东会会议，同意以2021年1月31日为基准日，将汇成有限整体变更为股份有限公司，股份制改造后名称变更为合肥新汇成微电子股份有限公司。截至目前，公司仍然依法存续。发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，符合《注册办法》第十条的规定。

发行人按原有限公司账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，自有限公司成立之日起计算，已持续经营三年以上，符合《注册办法》第十条的规定。

#### 2、发行人会计基础工作规范，内控制度健全有效

保荐机构查阅了发行人相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕278号标准无保留意见的审计报告，认为：发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人报告期内财务状况、经营成果、现金流量。符合《注册办法》第十一条第一款之规定。

保荐机构查阅了发行人内部控制制度，确认发行人内部控制所有重大方面是有效的。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕279号《内部控制鉴证报告》，认为发行人按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。符合《注册办法》第十一条第二款之规定。

### 3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

(1) 资产完整，人员、财务、机构及业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本保荐机构查阅了发行人主要合同、实地勘察了发行人及其子公司的经营场地，实地走访及视频访谈了主要客户及供应商，与发行人主要职能部门、高级管理人员和主要股东进行了访谈。

#### ①资产完整

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、资质的所有权或者使用权，具有独立的采购、研发和销售系统，公司资产完整。

#### ②人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### ③财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度并独立进行财务决策。公司根据《公司章程》的规定及自身情况作出财务决策，自主决定资金的使用。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

#### ④机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，已建立健全内部经营管理机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### ⑤业务独立

公司专业从事显示驱动芯片高端先进封装测试业务，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

**(2) 发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。**

保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会决议和记录，查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告。

经核查，保荐机构认为发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册办法》第十二条第二款之规定。

**(3) 发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。**

保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、商标等的权属文件，确认发行人主要资产、核心技术、商标等权属清晰，不存在重大权属纠纷的情况。保荐机构向银行取得了发行人担保的相关信用记录文件，核查了发行人相关的诉讼和仲裁文件，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

保荐机构查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告等，确认不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对发行人持续经营有重大不利影响的事项。发行人符合《注册办法》第十二条第三款之规定。

#### 4、发行人的规范运行

##### **(1) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。**

保荐机构查阅了发行人章程，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，查阅了发行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所，确认发行人主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务。发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。因此发行人符合《注册办法》第十三条第一款之规定。

**(2) 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。**

保荐机构取得了发行人关于不存在重大违法违规情况的说明，获取了相关部门出具的证明文件，确认最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。因此发行人符合《注册办法》第十三条第二款之规定。

保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈发行人董事、监事和高级管理人员，取得了相关人员的声明文件，确认发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。因此，发行人符合《注册办法》第十三条第三款之规定。

##### **(二) 发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元**

本次发行前，发行人股本总额为667,882,625元，注册资本为667,882,625元。若本次公开发行的222,627,542股（行使超额配售选择权之前）全部发行完毕，发行人股本总额将达到890,510,167元（行使超额配售选择权之前），超过3,000万元。

**（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上**

本次发行前发行人股本总额为667,882,625元，超过4亿元，本次拟公开发行新股不超过222,627,542股，不低于本次发行后总股本的10%，不超过25%（行使超额配售选择权之前），公司本次发行后总股本不超过890,510,167股（行使超额配售选择权之前）。

**（四）市值及财务指标符合相关规定**

**1、公司选取的市值及财务指标**

公司根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的要求，结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为第四套标准：“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。”

**2、公司财务指标及预计市值满足上述标准的分析**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人最近一年实现营业收入为79,569.99万元，超过3亿元。

结合最近一次外部股权融资情况、可比公司在境内外市场的估值情况，发行人预计市值不低于30亿元，满足所选择上市标准中的市值指标。

保荐机构认为，发行人本次发行上市符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的发行、上市条件。

**九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排**

发行人证券上市后，本保荐机构将严格按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求对发行人实施持续督导，持续督导期间为发行人股票上市当年剩余时间以及其后三个完整会计年度。

持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构将继续持续督导至相关工作完成。

督导事项	工作安排
(一) 持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会和上海证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；定期对发行人进行现场检查；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件	在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金；持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项。
6、持续关注发行人对外担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、相关制度以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行现场检查，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权审阅、核查发行人拟披露的所有文件；有权监督、调查发行人大股东或实际控制人执行相关法律法规的情况，可对其他关联方的基本情况进行尽职调查，并发表专业意见；有权督促发行人有效执行关联交易制度，并可对关联交易的公允性、合规性发表专业意见；有权督促发行人履行其向投资者和管理部门承诺的事项；有权按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；有权列席发行人股东大会、董事会、监事会及其他重要会议；有权依照法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对发行人的公司治理、规范运作、信息披露的缺陷直接向发行人股东大会、董事会提出专业建议。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，及时向保荐机构提供与本次保荐事项有关的各种资料；接受保荐机构尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合。
(四) 其他安排	本保荐机构将严格按照中国证监会、上海证券交易所的各项要求对发行人实施持续督导。



## **十、保荐机构和保荐代表人联系方式**

保荐机构：海通证券股份有限公司

保荐代表人：何立、吴俊

联系地址：上海市广东路689号

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

## **十一、保荐机构认为应当说明的其他事项**

无其他需要说明的事项。

## **十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论**

本保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。发行人符合科创板定位，具备在上海证券交易所科创板上市的条件。本保荐机构同意推荐合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，并承担相关保荐责任。

特此推荐，请予批准！

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: \_\_\_\_\_

保荐代表人签名: 何立      吴俊  
何立                      吴俊

2022年3月15日

2022年3月15日

内核负责人签名: 张卫东  
张卫东

保荐业务负责人签名: 任澎  
任澎

2022年3月15日

保荐机构总经理签名: 李军  
李军

2022年3月15日

2022年3月15日

保荐机构董事长、法定代表人签名: 周杰  
周杰



保荐机构: 海通证券股份有限公司

2022年3月15日